

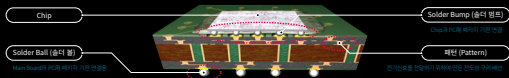
FCBGA (SC)

개요

OVERVIEW

반도체를 메인보드와 연결하기 위한 고집적 패키지 기판

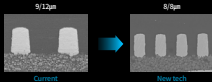
- 응용분야 : CPU, GPU, FPGA, AI 가속기 등



차별화

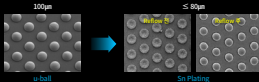
DIFFERENTIATION

미세 회로 개발



- 필요기술 : 미세도 노광 공법

미세 뱀프 개발



- 필요기술 : Sn Plating 공법

주요 사양

KEY SPECIFICATIONS

기판 층수	4~10층
Core 두께	400μm ↑
회로 (Line/Space)	9/12μm
Bump pitch	100μm

※ SC : Standard Core